



Rundbolzen/Walzplatten *Billets/Cakes* MB-P 20

Bezeichnung

Sauerstofffreies Kupfer mit geringem Phosphorzusatz

Designation

Oxygen-free copper with low phosphorus added

Spezifikationen

- Entspricht der Qualität MB-OF 100 versetzt mit ca. 20 ppm Phosphor
- Chemische Zusammensetzung in ppm / Gew %

Specifications

- Corresponds to quality MB-OF 100 with the addition of approx. 20 ppm phosphorus
- Chemical composition in ppm / wt %

Vergleich Comparison	Garantiewerte Guaranteed value	Typische Werte Characteristics
Cu + Ag + P	≥ 99,98 %	≥ 99,98 %
P-Gehalt / P content	10-40	20
Beständigkeit gegen Wasserstoffversprödung Hin-, Herbiegetest nach ISO 2626 <i>Resistance against hydrogen embrittlement Reverse Bend Test according to ISO 2626</i>	≥ 4 Biegungen bzw. 180° Umbiegung ≥4 reversals or 180° bend	12 Biegungen 12 reversals
Elektrische Leitfähigkeit <i>Electric conductivity</i>	≥ 100 % IACS	100,2 % IACS

Anwendung

- Elektrotechnik
- Elektronik
- Kollektorsegmente
- Plattierwerkstoffe

Application

- Electrical purposes
- Electronics
- Collector segments
- Cladding material

Vergleich mit internationalen Normen

Comparison with international standards

Norm Regelwerk Standard	Bezeichnung Name	Abweichung im Vergleich zur angeführten Norm Deviation from mentioned standard
ISO 431	Cu-PHCE	Höhere Reinheit, P-Gehalt eingeschränkt <i>Restricted P content, higher purity</i>
EN 1976	Cu-PHCE (CR020A)	
ASTM B 379	OFXLP (C 10300)	